

**528. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 12. September 1988
betreffend die Anmeldung von Topographien mikroelektronischer Halbleitererzeugnisse und das
Halbleiterschutzregister (Halbleiterschutz-Verordnung - HISchV)**

Auf Grund der §§ 9 Abs.4 und 10 Abs.4 des Halbleiterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 372/1988, wird verordnet:

Anmeldung

§ 1. Bei der Anmeldung der Topographie (§ 9 Abs. 1 HISchG) muß der Antrag auf Eintragung des Schutzes der Topographie in das Halbleiterschutzregister mit den übrigen im § 9 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 vorgeschriebenen Angaben getrennt von den Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie (§ 9 Abs.2 Z 2 HISchG) eingebracht werden.

Antrag

§ 2. (1) Der Antrag auf Eintragung des Schutzes der Topographie in das Halbleiterschutzregister (§ 9 Abs. 2 Z 1 HISchG) muß enthalten

1. den Namen und die Anschrift des Anmelders sowie gegebenenfalls seines inländischen Vertreters
2. bei natürlichen Personen die Staatsangehörigkeit oder, wenn der Anmelder nicht österreichischer Staatsbürger ist, seinen Wohnsitz bzw. bei juristischen Personen und Personengesellschaften des Handelsrechtes die tatsächliche Niederlassung.

(2) Als kurze und genaue Bezeichnung (Titel der Topographie) (§ 9 Abs.2 Z 1 HISchG) kann der Name oder die Produktbezeichnung der Topographie unter Angabe des Produktionsbereiches dienen.

(3) Das Datum des Tages der ersten nicht nur vertraulichen Verwertung der Topographie, wenn dieser Tag vor der Anmeldung liegt (§ 9 Abs. 2 Z 3 HISchG), ist anzugeben.

(4) Wenn die Anspruchsberechtigung auf § 3 Abs. 3 des Halbleiterschutzgesetzes gestützt wird, sind Angaben über die Staatsangehörigkeit und den ständigen Wohnsitz bzw. über den Ort der Niederlassung des nach § 3 Abs. 1 oder 2 des Halbleiterschutzgesetzes ursprünglich Anspruchsberechtigten und über die von diesem eingeräumte ausschließliche Zustimmung, die Topographie erstmals in Österreich nicht nur vertraulich geschäftlich zu verwerten, erforderlich.

Unterlagen

§ 3. (1) Zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie sind folgende Unterlagen einzureichen:

1. Zeichnungen oder Photographien von Layouts zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses,
oder
2. Zeichnungen oder Photographien von Masken oder ihren Teilen zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses,
oder
3. Zeichnungen oder Photographien von einzelnen Schichten des Halbleitererzeugnisses.

(2) Zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Unterlagen können Datenträger oder Ausdrucke davon oder das Halbleitererzeugnis selbst, für dessen Topographie Schutz beantragt wird, oder eine erläuternde Beschreibung eingereicht werden.

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthaltende Unterlagen

§ 4. (1) Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten und vom Anmelder als solche gekennzeichnet worden sind, sind bei der Anmeldung getrennt von den übrigen Teilen der Unterlagen einzureichen. Die Unterlagen können auch in einem Originalexemplar und in einem weiteren Exemplar (Zweitexemplar) mit unkenntlichgemachten Teilen eingereicht werden; in diesem Fall unterliegt das Zweitexemplar der Akteneinsicht im Umfang des § 18 Abs. 2 erster Satz des Halbleiterschutzgesetzes.

(2) Die Unterlagen nach Abs. 1 sind vom Patentamt unter Verschuß gesondert aufzubewahren.

(3) Ist Akteneinsicht in die Unterlagen nach Abs. 1 auf Anordnung der Nichtigkeitsabteilung oder des Gerichtes zu gewähren (§ 18 Abs. 2 zweiter Satz HlSchG), so sind diese Teile vom Patentamt unmittelbar an die Nichtigkeitsabteilung bzw. an das Gericht unter Verschuß und unter Hinweis auf die Geheimhaltungsbestimmungen zu übermitteln.

(4) Wird das Begehren auf Akteneinsicht in die Unterlagen nach Abs. 1 auf § 18 Abs. 3 des Halbleiterschutzgesetzes gestützt, so hat hierüber das nach der Geschäftsverteilung zuständige rechtskundige Mitglied der Rechtsabteilung (§ 16 Abs. 3 HlSchG) nach Anhörung des Schutzrechtsinhabers zu entscheiden.

Halbleiterschutzregister

§ 5. (1) In das Halbleiterschutzregister sind außer den im § 10 Abs. 2 des Halbleiterschutzgesetzes angeführten Angaben auch der Tag der Eintragung sowie ein Hinweis, welche Unterlagen nach § 9 Abs. 2 Z 2 des Halbleiterschutzgesetzes vorgelegt wurden, einzutragen.

(2) Die Einsicht in die gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 des Halbleiterschutzgesetzes vorgelegten Unterlagen umfaßt nicht auch das Recht, Kopien davon anzufertigen.

(3) Auszüge aus dem Halbleiterschutzregister umfassen nicht die gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 des Halbleiterschutzgesetzes vorgelegten Unterlagen.

Inkrafttreten

§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1988 in Kraft.

Graf